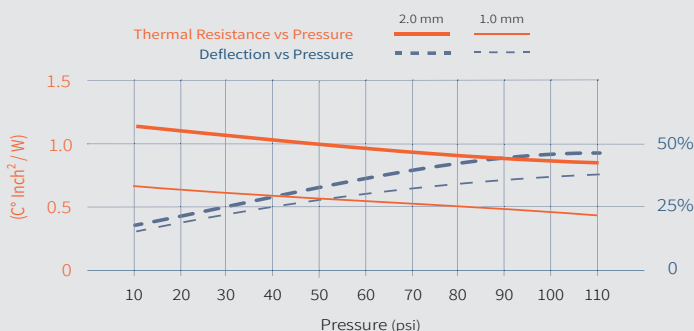


# Thermal Interface Material Silicone Gap Filler



Verstärkung  
Reinforced layer  
V = mit / with

Materialstärke  
Material thickness  
1.00 = 1.00 mm

DS-GAP-LS30-1.5-**X.XX**-**X**

## DS-GAP-LS30-1.5

Wärmeleitfähigkeit <sup>1</sup> Thermal Conductivity <sup>1</sup>	W/mK	1.50
Härte <sup>2</sup> Hardness <sup>2</sup>	Shore 00	30
Einsatztemperatur <sup>3</sup> Operation Temperature <sup>3</sup>	°C	-40 / +180
Materialstärke Material Thickness	mm	0.30 - 5.00
Durchschlagsfestigkeit <sup>4</sup> Dielectric Strength <sup>4</sup>	kV/mm	6.00
Verstärkung Reinforced Layer	√	optional
Konformität Conformity	√	RoHS
Dichte Density	g/cm <sup>3</sup>	2.40

1 Hot Disk 2 ASTM D2240 3 EN344 4 ASTM D149

REV2017\_01

Technische Änderungen vorbehalten, alle technischen Daten und Angaben unverbindlich.  
Subject to technical alterations, all technical data and details are not binding.